



FLASH 模块使用说明

JL_MOD_FH_V2.0 (FM25Q04)



JL_MOD_FH_V2.0 模块

模块芯片说明:

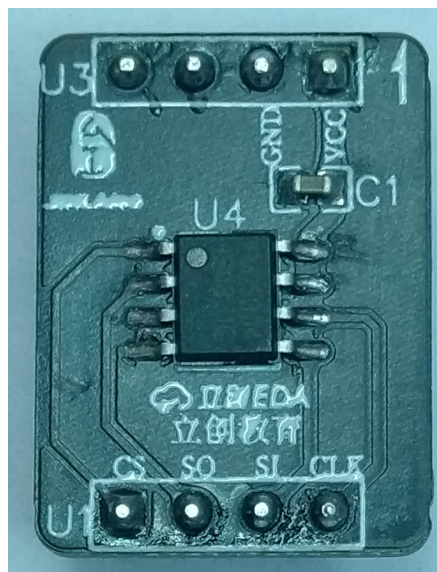
该模块采用 FM25Q04 封装为 SOIC-150mil 的 FLASH 芯片, 该串行闪存提供对于有限的空间, 引脚和电源系统的存储解决方案。

可以根据个人需求对芯片进行更换其型号为 FM25Q02、FM25Q08 等封装为 SOIC-150mil 的存储芯片

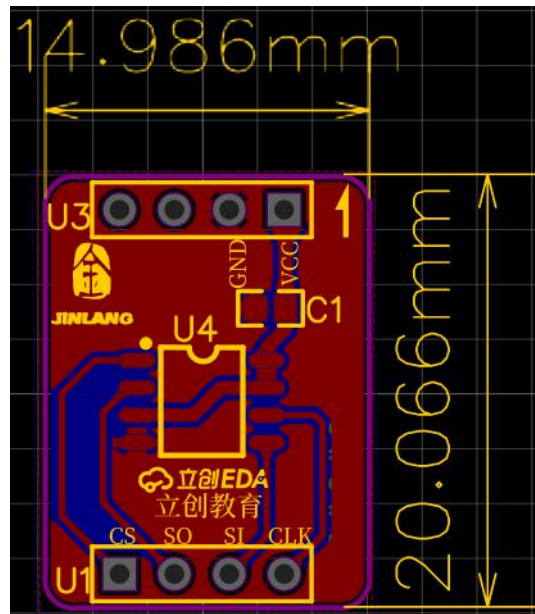
技术参数:

1. 工作电压: 2.3 ~ 3.6 V
2. 功耗: 1 μ A
3. 容量: 4M-bit/512K-byte
4. 接口: SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI, 支持时钟频率最高 104MHz
5. 支持以 4/32/64k-bytes 为单位进行 Sector/Block 擦除
6. 软件/硬件写保护功能
7. 10 万次擦除/编程寿命, 数据保存时间 20 年
8. PCB 外形尺寸: 20mm x 15mm

实物图:



引脚说明:



VCC: 该模块的供电电压为 3.3V，由开发板进行供电；

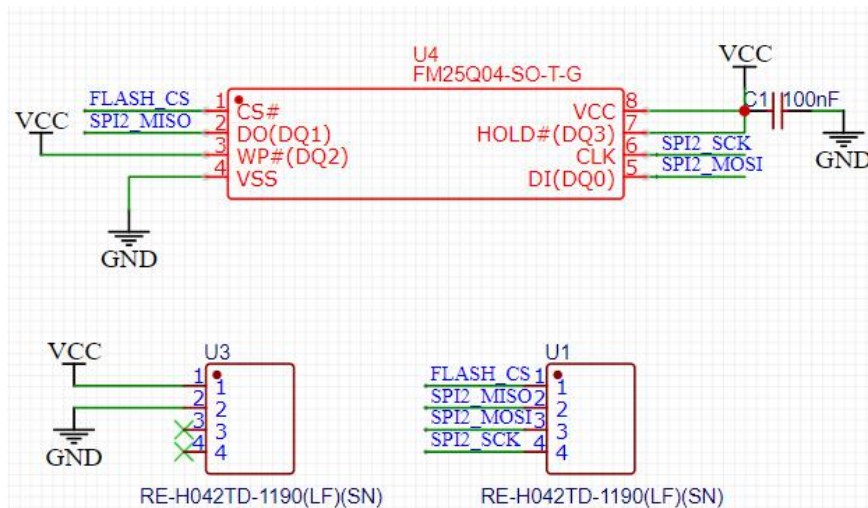
CS: 模块的片选输入，可启用或者禁用设备操作；

SO: 数据的输出；

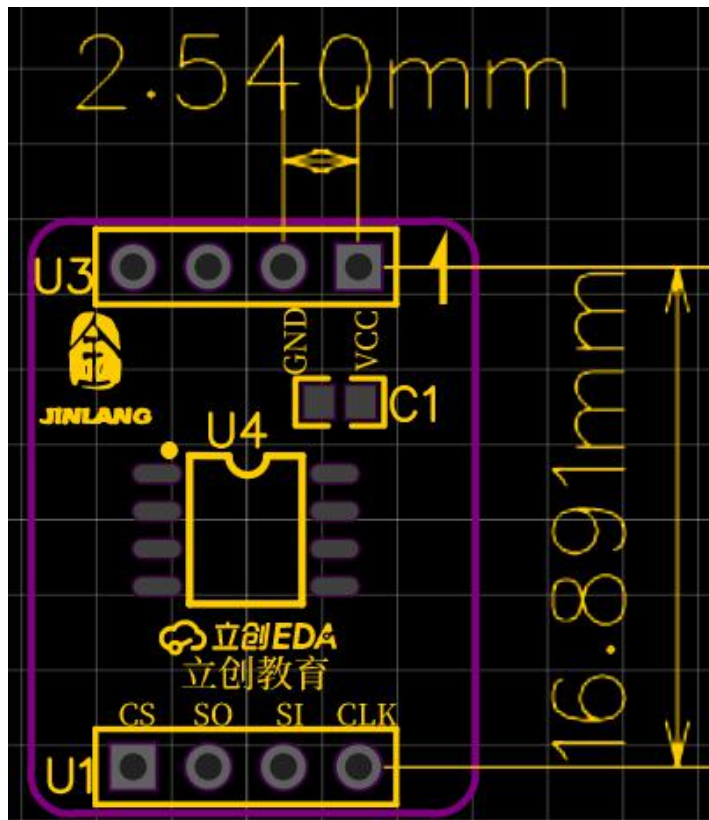
SI: 数据输入；

CLK: 串行时钟输入，提供串行输入和输出的时序。

原理图:



封装尺寸图:



注意事项:

在与开发板配合使用并安装该模块时要注意板子上标注的箭头方向与开发板上的标注一致。插反会导致模块不工作甚至烧毁模块上的芯片

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [jinlang](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[JL_MOD_FH_V1.0](#) [JL_MOD_FH_V2.0](#) [JL_MOD_LCD_2.8_V1.0](#)